**广东富信科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-011

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  □业绩说明会 □新闻发布会 ☑现场参观  □其他： 视频电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 1. 创华投资：李军辉 2. 恒江联合投资：周泽翊 3. 幸福阶乘基金：张东晓 4. 深天润：向干胜 5. 恒德投资：骆铭鸿、卢畅 |
| 时间 | 2024年12月9日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 公司接待人员  姓名 | 1. 董事会秘书：田泉 2. 证券事务代表：霍莹敏 |
| 投资者关系活动  主要内容介绍 | **机构与高管问答交流**  **问1：请问目前应用于400/800G光模块的Micro TEC进展如何？**  答：应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC验证周期较长，一般需要6个月以上。公司目前已与多家光模块厂商积极开展项目开发，处于小批验证阶段，验证进度取决于下游光模块厂商供应链国产化的诉求，力争今年内通过验证。后续如有进展，相关信息会在定期报告和对外公告中及时披露。  **问2：请问用于消费电子和用于通信领域的TEC产品有何差异？**  答：（1）尺寸微型。与常规用于消费领域的器件相比，用于通讯领域的器件是微型的。热电器件的微型化程度越高，其组装难度和加工难度越大，进行产业化生产需要足够的高端自动化设备、精密加工设备和熟练技术工人。  （2）可靠性。用于通讯领域的器件需要达到光电子器件通用可靠性保证要求（GR-468-CORE）和美国国防部发布的微电子器件试验方法标准（MIL-STD-883）两项国际先进测试标准的要求。  （3）热电性能。在相同输入功率下，用于通讯领域的器件的制冷深度和制冷量远大于用于消费领域的器件，热电性能更优良。  **问3：请问公司Micro TEC产品的产能充足吗？**  答：目前公司已具备年产300万片Micro TEC的生产能力，并可根据下游需求快速扩产。  **问4：请问目前市场上的温控解决方案与公司半导体热电制冷技术是什么关系？**  答：目前市场上的主流的温控解决方案有压缩机制冷、水冷、液冷等，半导体热电制冷技术与其他温控解决方案在技术特点、主要应用场景方面都存在较大差异，可以形成有效的互补，无法完全相互替代。  半导体热电制冷技术产品主要应用场景有：  （1）对尺寸、便携性、静音性要求较高的小容积、低冷量制冷场景，如消费电子领域的啤酒机、恒温酒柜；  （2）对微型化局部需要精准控温的场景，如通信领域的  光模块；  （3）对环境适应性要求较高的场景，如汽车领域的恒温  座椅。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应当披露重大信息。 |
| 附件清单（如有） | 无 |